

特点:

- 低插入损耗: 典型值 3.0dB
- 良好的带外抑制: $\geq 55\text{dB}$ @DC~380MHz
- 良好的带内驻波比: 典型值 1.5:1
- SMT 封装
- 封装尺寸: 10*5*3mm
- 产品执行标准为 SJ20527A-2003

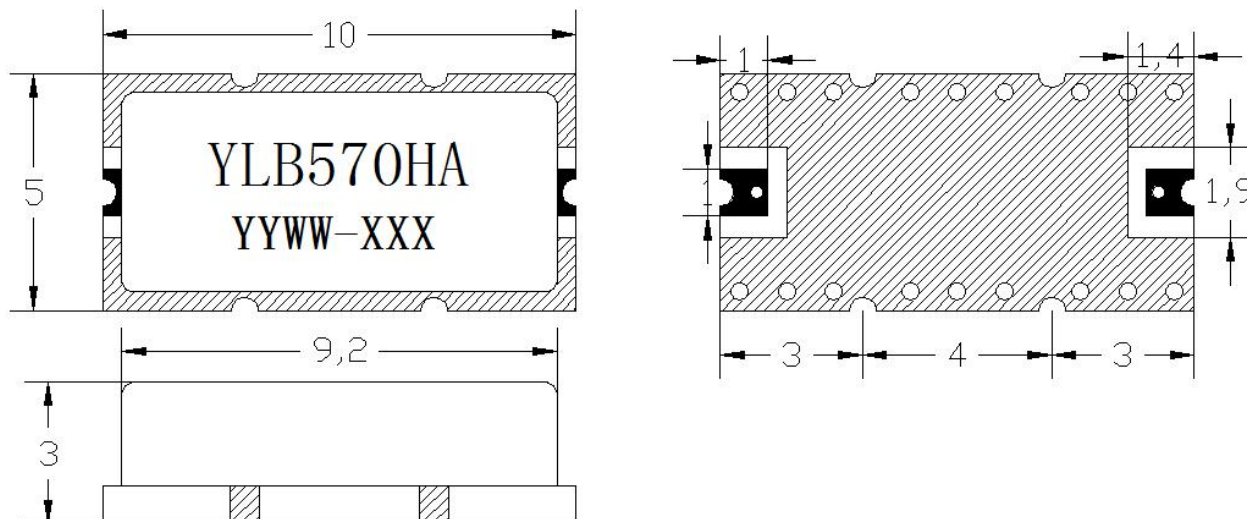
性能参数(25℃):

| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 参数值 | | | 单位 | 备注 |
|---------|-------------------|---|-----|-------|-------|-----|----|
| | | | MIN | TYP | MAX | | |
| 通带频率 | f_c | | 570 | | 850 | MHz | 全温 |
| 插入损耗 | IL | $P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=570\sim 850\text{MHz}$ | | 3.0 | 3.5 | dB | 全温 |
| 输入带内驻波比 | VSWR _i | | | 1.5:1 | 2.0:1 | | 全温 |
| 输出带内驻波比 | VSWR _o | | | 1.5:1 | 2.0:1 | | 全温 |
| 阻带抑制 | SR ₁ | $P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=380\sim 480\text{MHz}$ | 35 | | | dB | 全温 |
| | SR ₂ | $P_{IN}=0\text{dBm}$ $f_{TEST}=\text{DC}\sim 380\text{MHz}$ | 55 | | | | |
| 工作温度 | T | | -55 | | +85 | ℃ | |
| 质量 | m | | | | 5.0 | g | |

极限参数表:

| 参数名称 | 极限值 | 单位 | 参数名称 | 极限值 | 单位 |
|------|----------|----|--------|------|-----|
| 储存温度 | -55~+100 | ℃ | 输入射频功率 | 30.0 | dBm |

封装外形及引脚标识图:

 单位: mm 公差: ± 0.3


字符标志:

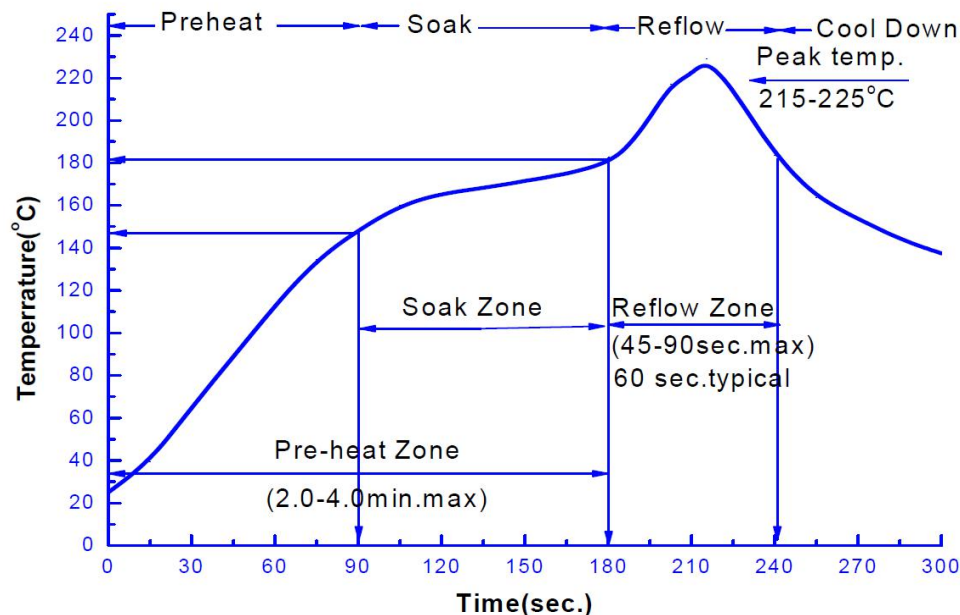
| | |
|----------|------|
| YLB570HA | 产品型号 |
| YYWW | 批次号 |
| XXX | 序列号 |

引脚定义:

| 接口标识 | 接口说明 |
|------|---------------------|
| ■ | RF IN, RF OUT (可互换) |
| ▨ | GND |

产品使用注意事项:

1. 产品属于静电敏感器件，产品在运输、装配使用过程中请注意静电防护；
2. 产品使用时请保证接地良好（GND 引脚和底部金属化区域），为了保证连接良好，底部引脚焊好之后，需对侧面引脚进行补焊；
3. 产品推荐采用 SMT 工艺贴片使用，采用 Sn63/Pb37 锡膏，熔点 183℃ 回流焊接，回流温度推荐曲线。



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过 220℃。

4. 如特殊情况需采用手工焊接，烙铁温度 350℃，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
5. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度 10~35℃，湿度 35~65%RH；对于需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
6. 客户在产品应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，客户在对产品焊接及清洗完成后，应对宇熙产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。